

「日印 半導体・AI産業ラウンドテーブル」に参加 インド半導体・AI分野との連携強化に向け TOMOE GAWAの取り組みを紹介



巴川コーポレーション
取締役 林隆一

株式会社巴川コーポレーション(本社:東京都中央区、代表取締役社長:井上雄介、以下 TOMOE GAWA)は、2026年8月25日にオクラ東京で開催された「India-Japan Industry Roundtable on Semiconductors and Artificial Intelligence」に参加しました。

会合は、インドのピューシュ・ゴヤル商工大臣の訪日に合わせて開催されたもので、半導体、人工知能(AI)、先端技術分野における日印連携の強化を目的として実施されました。

インド側は過去最大規模となる200名超のビジネス代表団を率いて来日し、日本の主要企業約20社の代表者と意見交換を行いました。会合では、半導体およびAI分野を日印協力の重要な領域として位置付け、日本の先端技術やものづくりの強みとインドのデジタル技術・人材基盤を組み合わせた連携の可能性について議論が行われました。また、サプライチェーン強靱化や投資・製造分野での協力拡大についても意見交換が行われました。

TOMOE GAWAからは取締役の林隆一が出席し、インド現地法人であるTOMOE GAWA AURA INDIA PVT. LTD.の活動実績をはじめ、機能性材料や熱・電気・電磁波をコントロールする「iCas(アイキャス)」ブランド製品、インド半導体関連企業に対する現在の取り組みについて紹介しました。

TOMOE GAWAは110年以上にわたり電気絶縁材料事業を展開しており、インド・ハイデラバードにおいても10年以上にわたり絶縁紙の生産・販売を行うことで、同国の電力インフラ整備に貢献してきました。近年では、データセンターや製造業の発展を支える電力インフラ分野への貢献も拡大しています。

会合では、トナー事業および半導体関連事業においてインド市場を重要な市場の一つと位置付けていることを説明するとともに、顧客とのパートナーシップを重視する事業モデルを通じて、インド企業やインドに進出する日系企業との連携を深めながら、インドの半導体産業の発展とサプライチェーン強化に貢献していきたい考えを伝えました。

また、半導体後工程(OSAT)を含む産業基盤の発展には安定したサプライチェーンの構築が重要であるとの認識を示すとともに、TOMOE GAWAとしてもパートナー企業と連携しながらその実現に貢献していく意向を述べました。あわせて、事業活動を通じて得られた知見を踏まえ、インドにおける貿易手続きに関する要望についても意見を述べました。

TOMOE GAWAは今後も、長年にわたり培ってきたインドとの関係を基盤に、インド企業およびインドに進出する日系企業とのパートナーシップを深めながら、半導体関連材料や先端機能材料事業を通じて、インドの産業発展とサプライチェーン強化に貢献してまいります。

